(19) 中华人民共和国国家知识产权局



(12) 实用新型专利



(10) 授权公告号 CN 205104180 U (45) 授权公告日 2016.03.23

- (21)申请号 201520840159.4
- (22)申请日 2015.10.26
- (73) 专利权人 亚世光电股份有限公司 地址 114031 辽宁省鞍山市高新区千山路 196 号
- (72) 发明人 肖瑀 徐晔
- (74) 专利代理机构 鞍山嘉讯科技专利事务所 21224

代理人 张群

(51) Int. CI.

GO9F 9/35(2006.01)

HO5K 3/02(2006.01)

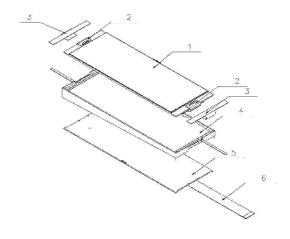
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种强抗静电高分辨率 ESTN 液晶显示模组

(57) 摘要

本实用新型涉及一种强抗静电高分辨率 ESTN 液晶显示模组,包括一个 4.3 英寸 ESTN LCD 显示屏,所述 LCD 显示屏邦定两颗 TAB IC 芯片,驱动 65X200 点阵像素,两颗 TAB IC 芯片与 PCB 板连接,LCD 显示屏下方设置 LED 背光源;LCD 显示屏上表面还镀有一层 ITO 透明导电膜,通过两个导电泡棉与 PCB 板相连;PCB 板贴片有阻容器件,通过 FFC 与外部MCU 相连。本实用新型采用 EC-COATING 技术,使模块外形成静电屏蔽防护罩,使用常规IC 芯片即可在强电磁干扰的环境下工作,抗静电能力大于 16KV;其采用两颗 TAB IC 芯片实现控制、驱动、DC/DC 转换,并可以实现四级灰度显示;整个模组体积小、便于安装,具有超低功耗。



- 1. 一种强抗静电高分辨率 ESTN 液晶显示模组,其特征在于,包括一个 4.3 英寸 ESTN LCD 显示屏,所述 LCD 显示屏邦定两颗 TAB IC 芯片,驱动 65×200 点阵像素,两颗 TAB IC 芯片与 PCB 板连接,LCD 显示屏下方设置 LED 背光源;LCD 显示屏上表面还镀有一层 ITO 透明导电膜,通过两个导电泡棉与 PCB 板相连;PCB 板贴片有阻容器件,通过 FFC 与外部 MCU 相连。
- 2. 根据权利要求 1 所述的一种强抗静电高分辨率 ESTN 液晶显示模组,其特征在于,所述 TAB IC 芯片内部集成 LCD 控制器、LCD 驱动器和 DC/DC 电源升压电路。
- 3. 根据权利要求 1 所述的一种强抗静电高分辨率 ESTN 液晶显示模组,其特征在于,所述 LCD 显示屏采用 EC-COATING 技术制造,上层 ITO 透明导电膜通过导电布连接到 PCB 板接地层,形成静电屏蔽防护罩。
- 4. 根据权利要求 1 所述的一种强抗静电高分辨率 ESTN 液晶显示模组, 其特征在于, 所述 LCD 显示屏采用半反半透显示模式, 可实现四级灰度显示。
- 5. 根据权利要求 1 所述的一种强抗静电高分辨率 ESTN 液晶显示模组,其特征在于,所述 LED 背光源采用底部发光十颗 SMT 灯芯,亮度保证在 500cd/m²。

一种强抗静电高分辨率 ESTN 液晶显示模组

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种 LCD 液晶显示模块, 尤其涉及一种强抗静电高分辨率 ESTN 液晶显示模组。

背景技术

[0002] LCD 屏作为主要显示设备,广泛应用于国防、工业、家用、公共设施等诸多领域;其中,工业用控制仪表显示器要求比较高,要求具有体积小、较宽的工作温度范围、低功耗、可实现灰度显示及显示各种文字等功能,并可在超强电磁干扰的环境中工作。而静电放电抗扰度问题直接关系到客户能否接受和认可,因此最为重要;同时由于液晶显示器件与一般电子产品相比具有许多特殊性,因此静电放电抗扰度问题也是最难解决的。

[0003] 传统的中尺寸液晶显示器采用 TAB 结构,易受静电干扰,其常规的静电指标 ESD 接触放电只有 10KV,在静电干扰比较大的环境很难正常使用,需要提高 IC 芯片的抗静电能力,即使用高性能的车载 IC 芯片,而这样又会增加产品成本。

发明内容

[0004] 本实用新型提供了一种强抗静电高分辨率 ESTN 液晶显示模组,采用 EC-COATING 技术,使模块外形成静电屏蔽防护罩,使用常规 IC 芯片即可在强电磁干扰的环境下工作,抗静电能力大于 16KV;其采用两颗 TAB IC 芯片实现控制、驱动、DC/DC 转换,并可以实现四级灰度显示;整个模组体积小、便于安装,具有超低功耗。

[0005] 为了达到上述目的,本实用新型采用以下技术方案实现:

[0006] 一种强抗静电高分辨率 ESTN 液晶显示模组,包括一个 4.3 英寸 ESTN LCD 显示屏,所述 LCD 显示屏邦定两颗 TAB IC 芯片,驱动 65×200 点阵像素,两颗 TAB IC 芯片与 PCB 板连接,LCD 显示屏下方设置 LED 背光源;LCD 显示屏上表面还镀有一层 ITO 透明导电膜,通过两个导电泡棉与 PCB 板相连;PCB 板贴片有阻容器件,通过 FFC 与外部 MCU 相连。

[0007] 所述 TAB IC 芯片内部集成 LCD 控制器、LCD 驱动器和 DC/DC 电源升压电路。

[0008] 所述 LCD 显示屏采用 EC-COATING 技术制造,上层 ITO 透明导电膜通过导电布连接到 PCB 板接地层,形成静电屏蔽防护罩。

[0009] 所述 LCD 显示屏采用半反半透显示模式,可实现四级灰度显示。

[0010] 所述 LED 背光源采用底部发光十颗 SMT 灯芯,亮度保证在 500cd/m²。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0012] 1) 采用 EC-COATING 技术,使模块外形成静电屏蔽防护罩,使用常规 IC 芯片即可在强电磁干扰的环境下工作,抗静电能力大于 16KV;

[0013] 2) 采用两颗 TAB IC 芯片实现控制、驱动、DC/DC 转换,并可以实现四级灰度显示;

[0014] 3) 采用 TAB 邦定技术,结构紧凑、体积小,便于安装,且具有超低功耗;

[0015] 4) 使用 LED 背光源可在夜间工作。

附图说明

[0016] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0017] 图中:1.LCD显示屏 2.TAB IC芯片 3.导电泡棉 4.LED 背光源 5.PCB 板 6.FFC

具体实施方式

[0018] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明:

[0019] 见图 1,是本实用新型的结构示意图。本实用新型一种强抗静电高分辨率 ESTN 液晶显示模组,包括一个 4.3 英寸 ESTN LCD (使用染料液晶的 STN-LCD) 显示屏 1,所述 LCD 显示屏 1 邦定两颗 TAB (Tape Automated Bonding,是指将 IC 封装在一种卷带上) IC 芯片 2,驱动 65×200 点阵像素,两颗 TAB IC 芯片 2与 PCB 板 5连接,LCD 显示屏 1下方设置 LED 背光源 4;LCD 显示屏 1上表面还镀有一层 ITO 透明导电膜,通过两个导电泡棉 3与 PCB 板 5相连;PCB 板 5贴片有阻容器件,通过 FFC 6与外部 MCU 相连。

[0020] 所述 TAB IC 芯片 2 内部集成 LCD 控制器、LCD 驱动器和 DC/DC 电源升压电路。

[0021] 所述 LCD 显示屏 1 采用 EC-COATING 技术制造,上层 ITO 透明导电膜通过导电布连接到 PCB 板 5 接地层,形成静电屏蔽防护罩。

[0022] 所述 LCD 显示屏 1 采用半反半透显示模式,可实现四级灰度显示。

[0023] 所述 LED 背光源 4 采用底部发光十颗 SMT (Surface Mounted Technology,即表面组装技术) 灯芯,亮度保证在 500cd/m²。

[0024] 所述的 EC-COATING 技术是一种特殊的刻蚀工艺,在刻蚀玻璃图形走线的同时,保留产品上片玻璃表面 ITO 透明导电膜,通过导电布连接到 PCB 板 5 接地层,形成静电屏蔽防护罩,达到强抗静电的功能。

[0025] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

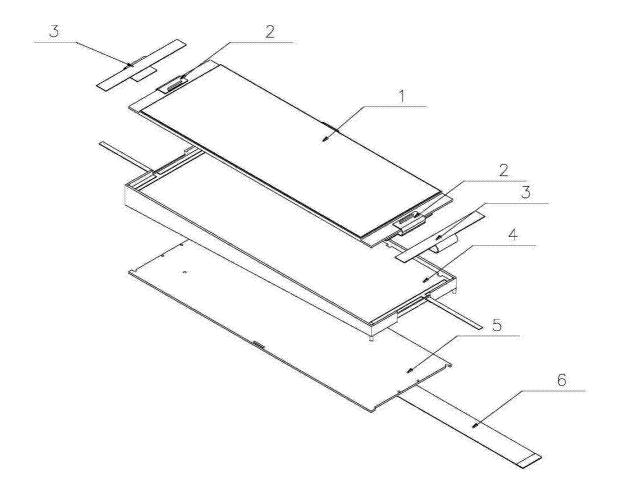


图 1



专利名称(译)	一种强抗静电高分辨率ESTN液晶显示模组			
公开(公告)号	CN205104180U	公开(公告)日	2016-03-23	
申请号	CN201520840159.4	申请日	2015-10-26	
[标]申请(专利权)人(译)	鞍山亚世光电显示有限公司			
申请(专利权)人(译)	亚世光电股份有限公司			
当前申请(专利权)人(译)	亚世光电股份有限公司			
[标]发明人	肖瑀 徐晔			
发明人	肖瑀 徐晔			
IPC分类号	G09F9/35 H05K3/02			
代理人(译)	张群			
外部链接	Espacenet SIPO			

摘要(译)

本实用新型涉及一种强抗静电高分辨率ESTN液晶显示模组,包括一个 4.3英寸ESTN?LCD显示屏,所述LCD显示屏邦定两颗TAB?IC芯片, 驱动65X200点阵像素,两颗TAB?IC芯片与PCB板连接,LCD显示屏下 方设置LED背光源;LCD显示屏上表面还镀有一层ITO透明导电膜,通过 两个导电泡棉与PCB板相连;PCB板贴片有阻容器件,通过FFC与外部 MCU相连。本实用新型采用EC-COATING技术,使模块外形成静电屏蔽 防护罩,使用常规IC芯片即可在强电磁干扰的环境下工作,抗静电能力 大于16KV;其采用两颗TAB?IC芯片实现控制、驱动、DC/DC转换,并可以实现四级灰度显示;整个模组体积小、便于安装,具有超低功耗。

